Наноструктурированные пленки *a*-Si: H, полученные методом разложения силана в магнетронной камере

© О.А. Голикова, М.М. Казанин, А.Н. Кузнецов, Е.В. Богданова

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 29 февраля 2000 г. Принята к печати 1 марта 2000 г.)

1. Введение

В наших предыдущих работах [1,2] было показано, что метод разложения силана в магнетронной камере (magnetron assisted SiH₄ decomposition: MASD) открывает широкие возможности контроля структуры и свойств получаемых пленок *a*-Si:H. Так, при постоянном содержании водорода ($C_{\rm H}$) величина микроструктурного параметра (R) может варьироваться от нуля до единицы, т. е. в предельных случаях пленки содержат либо только моногидридные комплексы (SiH), либо только дигидридные комплексы (SiH₂). Существенно, что такие вариации R достигаются при высоких температурах осаждения, обеспечивающих низкие $C_{\rm H}$ (до 3 ат%). Это считается отличительной особенностью метода MASD [2].

В [1,2] основное внимание уделялось пленкам, имеющим $R \cong 0$: их электронные параметры соответствовали параметрам *a*-Si: Н приборного качества. Однако пленки, имеющие высокие R = 0.65 - 1.0 представляют самостоятельный интерес.

Действительно, в работе [3] было установлено, что в отличие от пленок, имеющих $R \cong 0$ [4], пленки, имеющие R = 0.65 - 0.75, начинают кристаллизоваться при достаточно "мягких" воздействиях имплантации Si+ (энергия ионов 70 кэВ, доза $D = 10^{13}$ см⁻², T = 300 K, последующий отжиг в вакууме (3-4) · 10⁻⁶ Торр при 200°С в течение 1 ч). Это означает, что исходные пленки с R = 0.65 - 0.75 фактически являются наноструктурированными, хотя объемная кристаллическая фракция (X_c) в них столь мала, что ее невозможно обнаружить известными методами [3,5]. По терминологии авторов [5], такие пленки находятся "на границе кристалличности" (on the edge of crystallinity). Именно эти кристаллы весьма малых размеров, образующиеся в пленке в процессе ее осаждения, и служат центрами кристаллизации при последующих внешних воздействиях. Действительно, после имплантации Si⁺ величина микроструктурного параметра становится равной единице: это наблюдается при увеличении X_c, когда SiH₂-комплексы в основном располагаются на границах нанокристаллов [6].

В то же время, судя по величине R = 1, MASD позволяет получать пленки с подобной структурой, сформированной и непосредственно в процессе их осаждения, т.е. без каких-либо внешних воздействий.

Задача настоящей работы — определение особенностей электропереноса в различных наноструктурированных пленках *a*-Si:H, полученных при использовании метода MASD.

Эксперимент и обсуждение результатов

MASD представляет собой комбинацию двух процессов: разложение силана в плазме *dc*-разряда (используется газовая смесь 25%SiH₄-75%Ar) и магнетронного катодного распыления (sputtering) кристаллической Si-мишени.

Пленки получали при следующих технологических параметрах: анодном напряжении $V_A = 500$ В, магнитном поле H = 500 Гс, давлении газовой смеси $P \cong 3$ мТорр и скорости ее прокачки r = 1 s.c.c.m. Варьируемым технологическим параметром была температура осаждения: $T_s = 300-390^{\circ}$ С. Скорость осаждения пленок составляла r = 0.8-1.2 Å·s⁻¹, толщина пленок — d = 0.8-1.0 мкм.

Рассмотрим особенности метода MASD с точки зрения возможностей получения наноструктурированных пленок *a*-Si:H (с включениями нанокристаллов Si в аморфной матрице).

Во-первых, как это отмечалось в работе [7], исследования состава силан-аргоновой плазмы показали, что среди частиц различных Si–H-радикалов были обнаружены частицы нанокристаллов Si (с размерами до 2 нм), которые могут принимать участие в формировании структуры пленки.

Во-вторых, растущая пленка находится и под воздействием пучка частиц распыляемой мишени (Si атомов и ионов).

При достаточно высокой температуре осаждения подвижность всех этих частиц на поверхности растущей пленки возрастает. Отметим, что передача пленке энергии атомов и ионов Ar, отраженных от Si-мишени, фактически означает увеличение эффективной температуры осаждения. При этом тоже создаются условия образования нанокристаллов Si в аморфной матрице пленки.

Высокие температуры осаждения, с другой стороны, приводят к низкому содержанию водорода в пленках, что, по-видимому, является благоприятным фактором для роста нанокристаллов Si. Действительно, по мнению авторов [6], высокое содержание водорода (~ 20 ат%) приводит к образованию своеобразной "оболочки" во-круг растущих нанокристаллов, препятствуя увеличению их размеров.

Для определения зависимостей $C_{\rm H}$ и R от T_s при $P \cong 3$ мТорр (рис. 1) использовались данные, приведенные в [2]. Видно, что $R \cong 1$ достигается для пленок, осажденных при $T_s = 370-390^{\circ}$ С. Согласно данным



Рис. 1. Зависимости содержания водорода $(C_{\rm H})$ и микроструктурного параметра (R) от температуры осаждения пленок (T_s) . Давление газа 3 мТорр, скорость прокачки 1 s.c.c.m.

рамановской спектроскопии, объемная кристаллическая фракция (X_c) в них не превышает 20%, а размеры нанокристаллов (d_{Raman}) не превышают 5 нм. Поэтому эти двухфазные пленки по структуре представляют собой аморфную матрицу с распределенными в ней включени-ями нанокристаллов Si.

Действительно, как видно из рассмотрения температурных зависимостей темновой проводимости этих наноструктурированных пленок, наблюдаются две энергии активации σ_d (ΔE_1 и ΔE_2 — вблизи комнатной температуры и при повышенных температурах соответственно) (рис. 2, *a*). На этом рисунке представлены данные для пленок, имеющих близкие величины ΔE_2 (0.76–0.80 эВ). Тогда, если при повышенных температурах электроперенос определяется основной, высокоомной аморфной фазой, то при пониженных температурах становится заметным вклад в электроперенос второй, значительно более низкоомной фазы. При этом, так как $\Delta E_2 \cong$ const, по величинам ΔE_1 можно непосредственно судить о влиянии второй фазы.

В работе [6], где пленки получали методом РЕСVD при сильном разбавлении SiH₄ водородом, было показано, что величина фоточувствительности при комнатной температуре ($\sigma_{\rm ph}/\sigma_d$) падала по мере роста вклада в электроперенос кристаллической фазы. Приведенные на рис. 2, *b* данные согласуются с данными [6] (пленки *1–3*). Что касается величины фотопроводимости пленок (*1–3*), то при комнатной температуре они порядка 10⁻⁸ Си/см (измерения проводились при энергии падающего света $\varepsilon = 2$ эВ и скорости генерации фотоносителей $G \simeq 10^{19}$ см⁻³·с⁻¹). В интервале температур 200–300 К $\sigma_{\rm ph}$ возрастала с ΔE порядка сотых эВ.

Отметим, что сравнение величин σ_d и σ_{ph} , как и их энергии активации для PECVD-пленок [6] и рассмотренных выше MASD-пленок, не было бы корректным, поскольку содержание водорода в них отличается ($C_{\rm H} \cong 20 \, {\rm ar}\%$ и 5–6 ат% соответственно), что не может не сказаться как на сопротивлении границ между аморфной и кристаллической фазами, так и величинах σ_{ph} . На рис. 2, *а* представлена также температурная зависимость темновой проводимости одной из пленок после ионной имплантации кэВ-ионами Si⁺ [3]. До имплантации она имела $C_{\rm H} = 7 \, {\rm ar}\%$ и R = 0.75. После имплантации данная пленка содержала 5.6 ar% водорода и имела R = 1, т.е. в указанных отношениях она не отличалась от пленок (1-3) (рис. 2, *a*). На кривой $\lg \sigma_d(1/T)$ для нее так же наблюдаются два наклона: $\Delta E_1 = 0.3$ эВ, $\Delta E_2 = 0.75$ эВ. Однако, вопервых, величина σ_d этой пленки занижена, а, во-вторых, фотопроводимость для нее наблюдать не удается. Мы относим эти особенности за счет влияния не полностью отожженных радиационных дефектов.

Рассмотрим теперь особенности электропереноса в наноструктурированных пленках с R < 1, находящихся на границе кристалличности. На рис. 3 представлены температурные зависимости темновой проводимости и фотопроводимости одной из таких пленок в сравнении с теми же зависимостями, определенными для пленки,



Рис. 2. a — температурные зависимости темновой проводимости наноструктурированных пленок, имеющих R = 1, полученных в процессе осаждения (1–3) и после имплантации Si⁺ (4); b — отношение величины фотопроводимости к величине темновой проводимости ($\sigma_{\rm ph}/\sigma_d$) при T = 300 K в зависимости от ΔE_1 — энергии активации σ_d при пониженных температурах.

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 9



Рис. 3. Температурные зависимости темновой проводимости (1,3) и фотопроводимости (2,4) пленок, имеющих R = 0.65 и R = 1 соответственно.

имеющей после осаждения R = 1. В данном случае выбраны пленки, имеющие при высоких температурах близкие энергии активации темновой проводимости, равные $\Delta E \cong 0.90$ эВ. Видно, что если для пленки с $R = 0.65 \ \Delta E = 0.90 \ \text{эВ}$ наблюдается также и при пониженных температурах, то для пленки с R = 1, как и для других подобных по структуре пленок (рис. 2, a), при пониженных температурах наблюдается вторая, более низкая энергия активации (0.42 эВ). Таким образом, если вклад в электроперенос второй, кристаллической фазы для пленки с R = 0.65 не заметен, то для пленки с R = 1 он, напротив, весьма существен (рис. 3). Фотопроводимость этой пленки при комнатной температуре еще ниже, чем других, описанных выше пленок с подобной структурой ($\sigma_{\rm ph} \cong 10^{-9} \, {\rm Cu/cm}$), по-видимому, вследствие более низкого содержания водорода (3 ат%).

По характеру температурных зависимостей фотопроводимости пленки с R = 0.65 и R = 1 тоже отличаются: для первой из них видна область температурного гашения фотопроводимости (ТГФ), для второй, как и для других пленок с R = 1, $\sigma_{\rm ph}$ постоянно и слабо возрастает при повышении температуры (рис. 3).

ТГФ, наблюдаемое для ряда полупроводниковых материалов, часто объясняют в рамках известной модели Роуза [8], предполагающей существование двух уровней рекомбинации фотоэлектронов с резко различными величинами сечений захвата ($S_{n1} \gg S_{n2}$), причем уровень 1 находится вблизи середины щели подвижности, а уровень 2 — вблизи края валентной зоны. Тогда при достаточно больших величинах потока падающего света (F) наблюдается суперлинейность люксамперных характеристик (ЛАХ), $I_{ph} \sim F^n$, где n > 1. В случае a-Si:H, находящегося "на границе кристалличности", ЛАХ такого типа при $F = 10^{13} - 10^{15}$ см²/с действительно наблюдается, в отличие от линейных ЛАХ a-Si:H с повышенной фоточувствительностью [9,10] (рис. 4). Говоря о двух различных уровнях рекомбинации фотоэлектронов, следует, по-видимому, иметь в виду рекомбинацию через уровни оборванных Si–Si-связей, находящихся в аморфной матрице и на границах нанокристаллов. Однако этот вопрос, как и вопрос о причинах различий ЛАХ при $F < 10^{13} \text{ см}^2/\text{с}$ (рис. 4), требует дополнительного изучения.

Рассмотрим теперь кинетику фотопроводимости наноструктурированных пленок *a*-Si:H, имеющих R = 0.65, под действием света (мощность потока $W = 100 \text{ MBT/cm}^2$, длина волны $\lambda < 0.9 \text{ мкм}$, время освещения 5 ч. T = 300 K) в сравнении с кинетикой фотопроводимости пленок "стандартного" *a*-Si:H, имеющих величины *R*, близкие к нулю. Если $\sigma_{\rm ph} \sim t^{-\gamma}$, то параметр γ характеризует скорость деградации фотопроводимости.

В работе [11] для стандартного *a*-Si: Н было показано, что величина γ возрастает по мере сдвига уровня Ферми от середины щели подвижности в сторону зоны проводимости. Так, для двух пленок, осажденных при $T_s = 300^{\circ}$ С, имеющих $C_{\rm H} = 8-9$ ат% и R = 0, величины энергии активации темновой проводимости равны 0.84 и 0.75 эВ, а величины γ равны 0.20 и 0.46 соответственно. В то же время для "собственного" *a*-Si: H, когда $\Delta E \cong 0.85$ эВ, но величины $C_{\rm H}$ различны, γ уменьшается при уменьшении $C_{\rm H}$ (до 0.1, когда $T_s \cong 300^{\circ}$ С и $C_{\rm H} = 4$ ат%).

В отличие от вышесказанного величины γ , определенные для наноструктурированных пленок *a*-Si:H с R = 0.65, оказываются "нечувствительными" к изменениям как $C_{\rm H}$, так и ΔE : в любом случае $\gamma \cong 0$, т.е. эффект Стаблера-Вронского фактически отсутствует. Если, как это принято в настоящее время, образование мета-



Рис. 4. Люксамперные характеристики наноструктурированных пленок *a*-Si: H ($\lambda = 630$ нм, T = 300 K) по данным [9] (1) и по данным настоящей работы (2).

Материал пленки	<i>а</i> -Si:Н приборного качества	Наноструктурированный <i>a</i> -Si:H (настоящая работа)	Наноструктурированный <i>a</i> -Si: H [7,9,10]
σ_d , Си/см ($T = 300 \mathrm{K}$)	10^{-10}	$4\cdot 10^{-10}$	10 ⁻⁹
$\sigma_{\rm ph}, { m Cu/cm}~(T=300{ m K},$	$1.5\cdot 10^{-6}$	$4\cdot 10^{-7}$	$6\cdot 10^{-5}$
$\lambda = 630$ нм, $G = 10^{19}$ см $^{-3} \cdot c^{-1})$			
$\sigma_{ m ph}/\sigma_d$	$1.5 \cdot 10^4$	10 ³	$6\cdot 10^4$
ΤΓΦ	Нет	Есть	Есть
Показатель степени ЛАХ	0.9	0.42 и 1.15 до и после	1.0
$(T=300\mathrm{K},\lambda=630\mathrm{нм},$		$F = 4 \cdot 10^{12} \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{c}^{-1}$	
$F = 10^{11} - 10^{15} \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{c}^{-1})$		соответственно	
Показатель степени в выражении	0.1	0.0	$\gamma=0.6$ и $\gamma ightarrow 0$ до и после
$\sigma_{ m ph} \sim t^{-\gamma}$ при засветке, 300 К			$t = 3.5 \cdot 10^3$ с соответственно
N_D, cm^{-3} (CPM)	$3 \cdot 10^{16}$	$4\cdot 10^{16}$	$1.6\cdot 10^{16}$
E_u , мэВ (СРМ)	53	63	62
<i>C</i> _H , ат%	4	5.6	8.3
Основные моды инфракрасного	2000 (R = 0)	2090, 2000 ($R = 0.65$)	2000, 2030
поглощения, см $^{-1}$			

Параметры пленок ($T_s = 380^{\circ}$ С, $\Delta E = 0.9$ эВ)

стабильных дефектов (оборванных связей) под действием интенсивной засветки происходит при непременном участии диффузии водорода, то полученный результат находит свое объяснение. Действительно, в пленках с R = 0.65, находящихся на границе кристалличности, вопервых, больше половины водорода содержится в составе SiH₂-комплексов. Во-вторых, SiH₂-комплексы расположены на границах нанокристаллов, содержание которых в пленках так мало, что они, находясь далеко друг от друга, тем самым затрудняют диффузию водорода.

3. Заключение

Результаты сопоставления свойств различных наноструктурированных пленок, исследованных в настоящей работе, показывают, что наиболее интересными из них являются пленки, находящиеся на границе кристалличности.

Во-первых, они легко кристаллизуются и поэтому могут рассматриваться как базовый материал для производства пленок поликремния (*pc*), перспективного для ряда практических приложений, в частности, в фотовольтаических приборах, полевых транзисторах и интегральных схемах [12], а также для гибридных *a*-/*pc*-приборов большой площади [13].

Во-вторых, несколько уступая по своим электронным параметрам пленкам *a*-Si: Н приборного качества, они имеют и определенное преимущество: высокую стабильность под воздействием интенсивной засветки, что является чрезвычайно важным при использовании материала в фотовольтаических приборах. Однако наноструктурированные пленки *a*-Si: H, осажденные методом MASD, по величине фоточувствительности (σ_{ph}/σ_d) сильно уступают наноструктурированным пленкам, осажденным методом PECVD как из неразбавленного силана [8,9], так и из его смесей с H₂, He, Ar [7].

В таблице приведены некоторые данные, характеризующие пленки стандартного *a*-Si:Н приборного качества и наноструктурированные пленки *a*-Si:H, полученные методами MASD и PECVD. Пленки осаждались при равной температуре ($T_s = 380^{\circ}$ C) и имели одинаковую энергию активации темновой проводимости ($\Delta E = 0.9$ эВ), т. е. положение уровня Ферми в щели подвижности относительно края зоны проводимости во всех случаях было одним и тем же, но структурные и электронные свойства пленок оказывались весьма различными. Определение причин этих различий не входит в задачу настоящей работы и несомненно потребует дальнейших исследований в области технологии и физики наноструктурированных пленок.

Список литературы

- О.А. Голикова, А.Н. Кузнецов, В.Х. Кудоярова, М.М. Казанин. ФТП, 30, 1879 (1996).
- [2] О.А. Голикова, А.Н. Кузнецов, В.Х. Кудоярова, М.М. Казанин. ФТП, 31, 816 (1997).
- [3] О.А. Голикова, А.Н. Кузнецов, В.Х. Кудоярова, И.Н. Петров, Э.П. Домашевская, В.А. Терехов. ФТП, **34**, 86 (2000).
- [4] О.А. Голикова. ФТП, **33**, 464 (1999).
- [5] A.H. Mahan, W. Beyer, L.M. Williamson, J. Yang, S. Guha. ICAMS-18 Abstracts (USA, 1999) p. 147.
- [6] Yu. He, Ch. Yin, G. Cheng, L. Wang, X. Liu. J. Appl. Phys., 75, 797 (1994).
- [7] P. Roca i Cabarrocas. MRS Symposia Proc., 507, 1855 (1998).
- [8] A. Rose. Concept of Photoconductivy and Allied Problems (Interscience, N.Y., 1963).
- [9] О.А. Голикова, М.М. Казанин. ФТП, 33, 110 (1999).
- [10] О.А. Голикова, М.М. Казанин. ФТП, 33, 336 (1999).
- [11] О.А. Голикова, М.М. Казанин, В.Х. Кудоярова. ФТП, 32, 484 (1998).
- [12] K. Pangal, J.C. Sturm, S. Wagner. MRS Symposia Proc., 507, 277 (1998).

[13] P. Mei, J.B. Boyce, D.K. Folk, G. Anderson, J. Ho, J. Lu, M. Hack, R. Lujan. MRS Symposia Proc., 507, 3 (1998).

Редактор В.В. Чалдышев

Nanostructured *a*-Si: H films obtained by magnetron-assisted silane decomposition

O.A. Golikova, M.M. Kazanin, A.N. Kuznetsov, E.V. Bogdanova

loffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St.Petersburg, Russia

Abstract Investigations of nanostructured *a*-Si:H films obtained by the MASD technique under variations of the deposition temperature ($T_s = 300-390^{\circ}$ C) have been carried out. Among these films, those "on the edge of crystallinity" are of particular interest. They display a trend crystallization. Besides, despite having somewhat poorer electron transport as compared to that of the "standard" *a*-Si:H of the device-grade, they are preferrable because of their higher stability of the photoconductivity under light exposure.